

12

© 1992 г.

## ДВУМЕРНЫЙ АНАЛИЗ АНОДНООБРАБОТАННЫХ СЛОЕВ

*Л. М. Лыньков, С. Л. Прищепа, В. А. Самохвал, Л. В. Семеняков*

Разработан метод двумерного анализа, основанный на определении пространственной корреляции исследуемых пористых аноднообработанных (ПАО) слоев  $\text{Al}_2\text{O}_3$ . Приводятся корреляционные функции прямой и «обратной» поверхностей ПАО пленки  $\text{Al}_2\text{O}_3$ . Рассматриваются процессы, проходящие при анодировании двухслойной структуры  $\text{Al}-\text{Nb}$ .

### Введение

При создании новых объектов микроэлектроники на основе пористых аноднообработанных слоев алюминия возникает необходимость качественной и количественной оценки структур. На практике часто можно ограничиться субъективными оценками. Однако при определении степени упорядоченности расположения пор требуется дополнительная информация, которую можно получить только в результате специальной обработки или измерений. Развитие вычислительной техники способствует широкому применению средств цифровой обработки изображений в научных исследованиях. Количественную информацию о степени упорядоченности расположения пор можно применять для оценки качества технологии. В [1] степень упорядоченности расположения пор оценивалась нами по одной скалярной величине — расстоянию между ближайшими соседними элементами. В этом случае мы определяем среднее расстояние между порами и другие гистограммные признаки. Однако этот метод не позволяет получить полную информацию о пространственной корреляции образцов.

В данной работе предложен сравнительно простой метод двумерного анализа, основанный на определении пространственной корреляции исследуемых пористых аноднообработанных структур. В его основе — умножение исходного и смешенного изображений. Для компонент  $r$  и вектора смещения строится усредненная автокорреляционная матрица. Предполагается, что для некоррелированной (апериодической) структуры распределение будет стремиться к равномерному. Периодические, т. е. скоррелированные структуры, выявляются по характерным максимумам двумерного распределения при соответствующих значениях  $r$  и  $\varphi$ .

### Алгоритм обработки изображения

Поверхность пористообработанного материала можно представить как дискретное изображение — массив чисел  $F(x,y)$ . Преобразование непрерывного (аналогового) изображения в эквивалентный цифровой массив можно осуществить на интерактивной планшетке оцифровкой контуров пор под управлением ЭВМ.

Пусть функция  $F(x,y)$  описывает исходное непрерывное изображение, пред-

ставляя распределения оптической плотности (яркости). В идеальной системе дискретизации изображений пространственные отсчеты исходного изображения получаются фактически путем перемножения этой функции с пространственно дискретизирующей функцией

$$S(x, y) = \sum_{j_1=-\infty}^{\infty} \sum_{j_2=-\infty}^{\infty} \delta(x - j_1 \Delta x, y - j_2 \Delta y), \quad (1)$$

состоящей из бесконечного числа  $\delta$ -функций, заданных в узлах решетки с шагом ( $\Delta x, \Delta y$ ). Тогда дискретизированное изображение описывается соотношением

$$F_D(x, y) = F(x, y)S(x, y) = \sum_{j_1=-\infty}^{\infty} \sum_{j_2=-\infty}^{\infty} F(j_1 \Delta x, j_2 \Delta y) \delta(x - j_1 \Delta x, y - j_2 \Delta y). \quad (2)$$

В выражении (2) учитывается, что функцию  $F(x, y)$  можно внести под знак суммирования и задать ее значение только в точках отсчета ( $j_1 \Delta x, j_2 \Delta y$ ). Величина шага сканирования выбирается из условия  $\Delta x, \Delta y \ll D$ , где  $D$  — средний размер поры.

В случае однофазной структуры (отсутствует квантование по яркости) имеет смысл провести пороговое преобразование каждой точки изображения  $F_D(x, y)$  по принципу «да—нет», так что для точек структуры (в местах расположения пор)  $F_D(x, y) = 1$ , а для фоновых точек (между порами)  $F_D(x, y) = 0$ .

Двумерный анализ структуры проводили на основе операции сдвига. Введем оператор сдвига  $S(\delta)$  [ ], так что

$$F(x, y, \delta) = S(\delta) [\tilde{F}(x, y)]. \quad (3)$$

Рассмотрим операцию логического умножения исходного и сдвинутого изображений

$$\Phi(x, y, \delta) = F(x, y) \times S(\delta) [F(x, y)]. \quad (4)$$

Учитывая, что  $F(x, y)$  и  $F(x, y, \delta)$  принимают значения либо 0, либо 1, и, просуммировав все выражения по  $x, y$ , получим количественную оценку этой операции

$$\Phi(\delta) = \sum_x \sum_y \Phi(x, y, \delta). \quad (5)$$

Выражение (5) по существу представляет собой площадь, занимаемую изображением  $\Phi(x, y, \delta)$ , т.е.

$$\Phi(\delta) = \text{area} \{F(x, y) \times F(x, y, \delta)\}. \quad (6)$$

Можно утверждать, что  $\Phi(\delta)$  представляет собой некоторый абсолютный показатель степени наложения изображения  $F(x, y)$  на себя при некотором сдвиге на вектор  $\delta$ .

Для установления пространственных признаков изображения определим величины  $\Phi(\delta)$  для определенного набора значений компонент  $r$  и  $\varphi$  вектора сдвига  $\delta$ . Если значения  $r$  и  $\varphi$  квантованы в диапазонах  $0 \leq r \leq M-1$ ,  $0 \leq \varphi \leq N-1$ , то  $\Phi(\delta) - \Phi(r, \varphi)$  представляет собой матрицу размером  $M \times N$ . Для нерегулярной структуры распределение  $\Phi(r, \varphi)$  должно стремиться к равномерному. В случае периодической структуры при некоторых  $r$  и  $\varphi$   $\Phi(r, \varphi)$  будет достигать выраженного максимума при достаточной пространственной корреляции. Удобнее рассматривать нормированную величину

$$S(r, \varphi) = \Phi(r, \varphi) / \text{area} \{F(x, y)\}. \quad (7)$$

При этом в случае идеальной периодической структуры для величин  $r_t$  и  $\varphi_t$ , определяющих ее пространственные периоды, имеет место полное наложение

при сдвиге на вектор  $\delta_T$ , так что  $S(r_T, \varphi_T) = 1$ . По существу  $S(\delta)$  представляет собой пространственную автокорреляционную функцию, вычисленную для некоторой области изображения. На рис. 1 приведен вид функции  $S(r, \varphi)$  для искусственно синтезированной идеальной структуры — элементы локализованы в узлах треугольной решетки. Видно, что максимумы первого порядка функции наблюдаются с периодом по  $\varphi$  в  $60^\circ$ , что соответствует идеальной треугольной решетке. Пик при  $R = 0$  соответствует наложению изображения на самого себя.

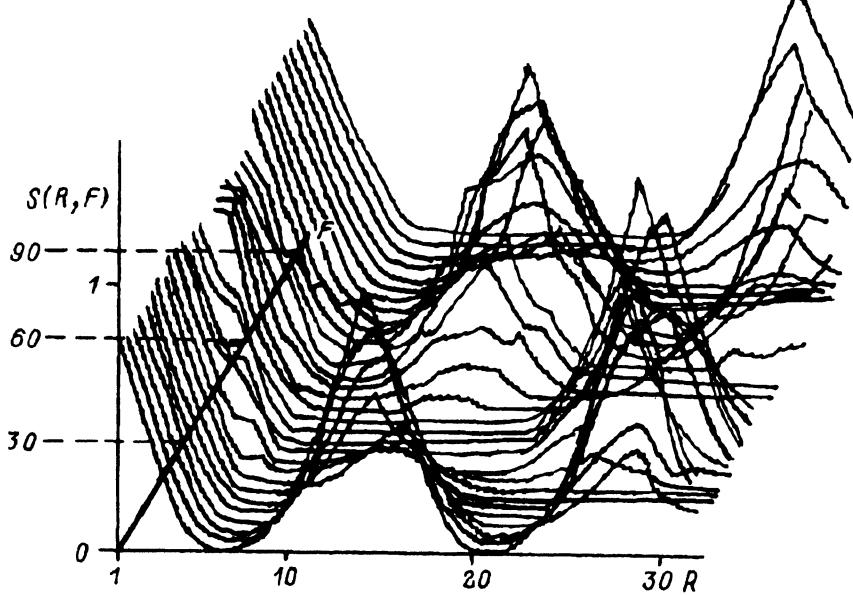


Рис. 1. Автокорреляционная функция  $S(r, \varphi)$  для структуры, представляющей собой идеальную треугольную решетку.

Ось  $OX$  —  $R$ -направление вектора сдвига, ось  $OY$  —  $F$ -направление вектора сдвига, ось  $OZ$  —  $S(R, F)$  (автокорреляция).

Алгоритм реализовывался на текстурно-анализирующей системе Leitz-TAS (ФРГ).

### Результаты и обсуждение

Объект исследования — поверхности пористых аноднообработанных слоев Al выбран нами неслучайно. Процессы анодной обработки металлов, полупроводников, тонкопленочных структур на их основе все шире используются для создания элементов микроэлектроники. Благодаря методам сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии установлено, что анодные пленки Al представляют собой ячеисто-пористую структуру и состоят из гексагонально расположенных плотно упакованных оксидных ячеек, каждая из которых содержит расположенную по оси пору [2, 3].

Характерный размер ячеек составляет  $0.1\dots0.5$  мкм. Он определяется условиями протекания процесса электрохимического анодирования: природой электролита и его концентрацией, плотностью анодного тока (величиной анодного потенциала), а также качеством исходной поверхности. Таким образом, идеальная структура пор представляет собой треугольную решетку.

Кроме того, исследовался порядок расположения пор и внутри слоев  $Al_2O_3$ . Для этого использовалась методика приготовления образцов, описанная в [4]. Суть ее заключается в анодировании двухслойной структуры  $Al-Nb$ . Первоначально

чально формирование ячеисто-пористой структуры анодной оксидной пленки Al происходит по обычному процессу [5, 6]: зарождение и рост оксидных ячеек, упорядочение образованной ячеисто-пористой структуры, рост анодного оксида при установленном потенциале или плотности анодного тока. Этот процесс сопровождается встречной миграцией через барьерный слой ионов  $O^{2-}$  из электролита и ионов  $Al^{3+}$ , в ходе которого происходит частичное растворение барьерного слоя у основания пор и одновременное его наращивание в глубь пленки алюминия. В этот период все анодные процессы протекают приблизительно с одинаковой скоростью при постоянном анодном токе и потенциале.

В момент достижения фронта анодирования пленки Nb установленное равновесие нарушается: в гальваностатическом режиме происходит увеличение анодного потенциала, а в потенциостатическом — снижение плотности анодного тока. В этот период в рассматриваемой системе начинают происходить следующие процессы. Под воздействием электрического поля ионы  $O^{2-}$ , диффундирующие из электролита, достигают поверхности Nb в месте его контакта с барьерным слоем и окисляют его. Но так как образуемая пленка  $Nb_2O_5$  обладает более высокими барьерными свойствами (более высоким сопротивлением полному току), то происходит перераспределение плотности анодного тока от центра основания поры к ее краям, что и приводит к росту анодного потенциала и утолщению локально окисляемой области  $Nb_2O_5$ . Постоянно продолжающееся растворение барьерного слоя со стороны поры также способствует росту оксидной области у Nb. После того как доанодирование (боковое окисление Al) завершается, система опять стремится к равновесию. Под порами в  $Al_2O_3$  образуются окисленные области  $Nb_2O_5$ , размеры которых определяются размерами пор в пленке  $Al_2O_3$  и величиной установленного анодного потенциала  $E_a$  [4, 7, 8]. Оксид Nb имеет коэффициент объемного роста  $n \sim 2.5$  [9]. За счет этого  $Nb_2O_5$  встраивается в поры  $Al_2O_3$ . Расположение и размеры выступов  $Nb_2O_5$  идентичны расположению и размерам пор в  $Al_2O_3$ . Стравливая слой  $Al_2O_3$  в водном растворе  $HNO_3$ , получим «след» поверхности пористообработанной пленки  $Al_2O_3$  в виде столбчатой структуры из  $Nb_2O_5$  на поверхности ниобиевой пленки (рис. 2).

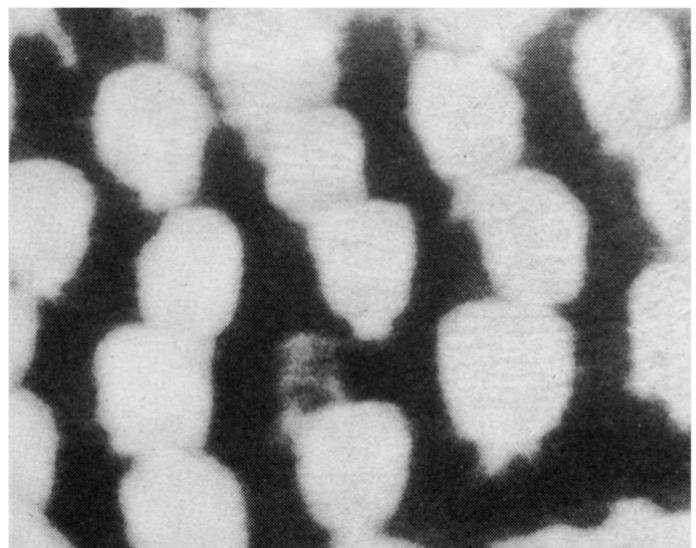


Рис. 2. Поверхность пленки Nb после анодной обработки через поры в  $Al_2O_3$ .  
Столбики — участки  $Nb_2O_5$ .

На рис. 3, а приведена автокорреляционная функция поверхности пористой аноднообработанной пленки  $Al_2O_3$ , а на рис. 3, б — автокорреляционная функция «обратной» поверхности этой пленки. Очевидно, что степень регуляр-

ности выше во втором случае. В первом случае корреляционные максимумы расположены через  $60^\circ$ , во втором — через  $55^\circ$ . Максимальное значение  $S(r, \varphi)$  для «обратной» поверхности в 2.5 раза больше, чем для поверхности  $\text{Al}_2\text{O}_3$ . Этот факт находит свое объяснение в том, что на начальной стадии ано-дирования поры могут образовываться в местах повышенного тепловыделения при протекании тока: на границе зерен, в местах дислокаций, расположения посторонних примесей на поверхности пленки, в участках аномально больших внутренних напряжений.

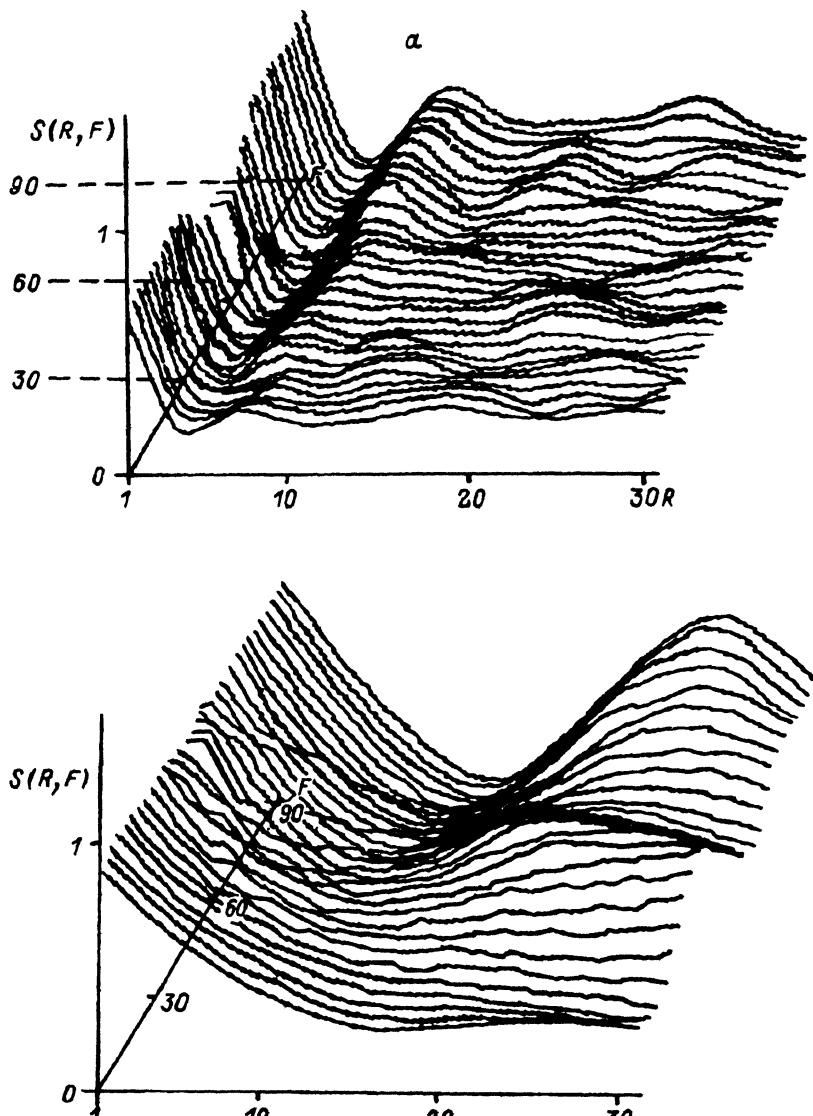


Рис. 3. Автокорреляционные функции.

Ось  $OX$  —  $R$ -направление вектора сдвига, ось  $OY$  —  $F$ -направление. Значения отложены в гра- дусах. Ось  $OZ$  —  $S(R, F)$  (автокорреляция);  $\alpha$  — поверхность пористой аноднообработанной пленки  $\text{Al}_2\text{O}_3$  (1 шаг сдвига равен  $22.03 \text{ нм}$ ),  $\beta$  — «обратная» поверхность пористой аноднообработанной пленки  $\text{Al}_2\text{O}_3$  (1 шаг сдвига равен  $7.34 \text{ нм}$ ).

Исходная пленка Al поликристаллическая, имеет дефектную структуру с плотностью дислокаций на поверхности  $10^{15} \dots 10^{16} \text{ м}^{-2}$ . Кроме того, сам алюминий покрыт естественной оксидной пленкой с плотностью дефектов поверхности, сравнимой с дефектностью алюминия [10]. Повышение температуры вызывает увеличение степени растворения оксида. Поэтому при толщинах пленок Al менее 1 мкм не удается, как правило, стабилизировать процесс формирования ячеистой плотноупакованной структуры [11]. Необходимо повышать формирующее напряжение, а значит, и глубину пор, чтобы между имеющимися ячейками образовались новые, постепенно заполняя всю поверхность металла. При этом в неизменных режимах анодирования (анодном потенциале, плотности анодного тока) происходит перераспределение ячеистых структур по глубине пленки. Так называемые «лишние» поры сливаются с «основными». С ростом глубины анодирования повышается степень упорядоченности, что и находит свое отражение в увеличении пиков автокорреляционной функции на рис. 3, б.

## Выводы

1. Разработана методика двумерного анализа однофазных тонкопленочных структур, основанная на определении пространственной корреляционной функции.
2. Впервые построены экспериментальные автокорреляционные функции поверхности пористообработанного Al. Доказано увеличение степени корреляции расположения пор с ростом толщины пленки Al.
3. Разработанная методика в совокупности с традиционными методами может быть использована для контроля качества пористых анодных оксидов.

## Список литературы

- [1] Дедю В.И., Лыков А.Н., Прищепа С.Л. и др. // Препринт ФИАН СССР. М., 1988. № 27. 39 с.
- [2] Thompson G.E., Wood G.C. // Treatise on Materials Science and Technology. New York, 1983. Vol. 23. P. 203–329.
- [3] Keller F., Hunter M.S., Robinson D.L. // Electrochim. Soc. 1953. Vol. 100. N 9. P. 411–419.
- [4] Лыньков Л.М., Прищепа С.Л., Семеняков Л.В. // Тез. докл. I Всесоюз. конф. «Электрохимическая анодная обработка металлов». Иваново, 1988. С. 28.
- [5] Thompson G.E., Furneaux R.G., Wood G.C. et al. // Nature. 1978. Vol. 272. N 5648. P. 433–435.
- [6] Labunov V.A., Sурганов V.F., Gorokh G.G., Mozalev A.M. // Extended abstracts of XI Intern. Congress on Electron Microscopy. Кyoto (Japan), 1986. P. 1020–1021.
- [7] Лыньков Л.М., Прищепа С.Л., Семеняков Л.В. // Матер. V конф. «Микроэлектроника». Братислава, 1989.
- [8] Сурганов В.Ф., Мозалев А.М. // ДАН БССР. 1990. № 3. С. 234–237.
- [9] Кубашевский О., Гопкинс Б. Окисление металлов и сплавов. М.: Металлургия, 1965.
- [10] Гутман Э.М. Механохимия металлов и защита от коррозии. М.: Металлургия, 1981.
- [11] Томашев Н.Д., Тюкина М.Н., Заливалов Ф.П. Толстослойное анодирование алюминия и его сплавов. М.: Машиностроение, 1968.

Минский радиотехнический институт

Поступило в Редакцию

6 августа 1990 г.